

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The defect is caused by a contact of a sharp-edged knife or a hard and fine foreign object on a cured solder resist surface (After solder resist application)

2-3-2-4 SR 導体間剥がれ／SR 在导线之间剥落 / Solder resist missing between conductors

【特徴】 導体間のSRが剥がれて無くなっている状態の欠陥

【特征】 SR 在导线之间剥落，成为中空的缺陷。

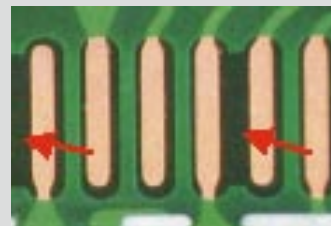
【Characteristics】 Solder resist between conductors is peeled off.

【原因・判断ポイント・発生工程】 露光不足によるPSRアンダーカット部などの、導体間の細いSRが乾燥後に何らかの衝撃を受け剥離して出来たもの（SR塗布乾燥後工程）

【原因、判断要点、发生工序】 由于曝光不足，在PSR侧蚀部位等的导线之间的SR烘干后，受某种物体的冲击剥落所引起的（SR烘干后工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

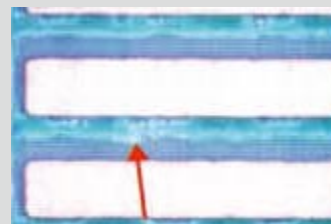
The defect is caused by the stripping of solder resist between conductors by an impact where the width of solder resist is thin and there is an under cut due to insufficient exposure.



【コメント】
上部導体間のSRが剥離している
顕微鏡倍率×

【注釋】
SR 在上部导线之间的剥落
显微镜倍率 ×

【Comments】
Upper part of solder resist between conductors is peeled off.
Magnification: ×



【コメント】
部分的にPSRが取れかかっている
顕微鏡倍率×30

【注釋】
SR 的局部被削掉
显微镜倍率 ×30

【Comments】
Photosolder resist is about to come off partially.
Magnification: ×30

2-3-2-5 部分金めっき境界部SR剥れ／在局部镀金层的边界SR剥落 / Peeled solder resist along locally plated gold deposited boundary

【特徴】 部分金めっき境界部分に沿ってPSRが剥離している状態の欠陥

【特征】 SR 沿着局部镀金层的边界剥落的缺陷。

【Characteristics】 Photo solder resist is peeled off along the locally plated gold deposit boundary.



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

【原因・判断ポイント・発生工程】 部分金めっき境界部分が、金めっき液に侵食されたことにより、PSRと導体銅の密着強度が阻害されてできたもの